

● 产品简介:

本型号产品采用陶瓷工艺与半导体工艺相结合的工艺技术制作而成,为两端轴向引出纯正玻璃封装结构。

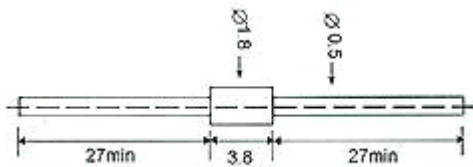
● 应用范围:

- 家用电器（如空调机、微波炉、电风扇、电取暖炉等）的温度控制与温度检测
- 办公自动化设备（如复印机、打印机等）的温度检测或温度补偿
- 工业、医疗、环保、气象、食品加工设备的温度控制与检验
- 液面指示和流量测量
- 手机电池
- 仪表线圈、集成电路、石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿

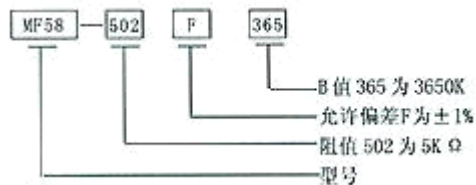
● 特点:

- 稳定性好, 可靠性高
- 阻值范围宽: $0.1 \sim 1000K \Omega$
- 阻值精度高
- 由于采用玻璃封装, 可在高温和高湿等恶劣环境下使用
- 体积小、重量轻、结构坚固, 便于自动化安装（在印制线路板上）
- 热感应速度快、灵敏度

● 外形尺寸



● 产品标示说明



● 主要技术参数

- 额定零功率电阻值范围 (R 25): $0.1 \sim 1000K \Omega$
- R 25允许偏差: $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 $\pm 3\%$ 、 $\pm 5\%$
- B 值范围 (R 25/50 $^{\circ}C$): $3100 \sim 4500K$
- B 值允许偏差: $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 $\pm 3\%$ 、 $\pm 5\%$
- 耗散系数: $\geq 2mW/^{\circ}C$ (在静止空气中)
- 热时间常数: $\leq 20S$ (在静止空气中)
- 工作温度范围: $-55^{\circ}C \sim +200^{\circ}C$